

ELMOS Semiconductor AG
Dortmund

Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2005

- Zur Einreichung zum Handelsregister -

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Dortmund, 10. März 2006

Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Brorhilker	Sultana
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

ELMOS Semiconductor AG, Dortmund
Gewinn- und Verlustrechnung für 2005

Anlage 2

	EUR	2004 TEUR
1. Umsatzerlöse	124.911.320,17	127.143
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.518.463,07	1.171
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	428.914,18	913
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.952.848,65</u>	<u>7.499</u>
	130.811.546,07	<u>136.726</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-16.404.675,98	-14.296
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-31.156.447,09	-26.836
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-25.542.559,60	-23.441
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 69.902,00 (Vj. TEUR 511)	-4.685.879,70	-4.740
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.334.852,56	-6.894
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-36.935.017,36</u>	<u>-37.156</u>
	-124.059.432,29	<u>-113.363</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	2.416.746,72	656
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.416.746,72 (Vj. TEUR 656)		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.639.611,15	3.945
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	316.696,78	1.280
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 92.118,39 (Vj. TEUR 685)		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.058.670,20	-5.576
davon an verbundene Unternehmen EUR 135.980,91 (Vj. TEUR 71)		
	<u>1.314.384,45</u>	<u>305</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.066.498,23	<u>23.668</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.735.595,59	-8.945
15. Sonstige Steuern	<u>-206.821,10</u>	<u>-323</u>
	-1.942.416,69	<u>-9.268</u>
16. Jahresüberschuss	6.124.081,54	14.400
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>36.408.865,71</u>	<u>26.062</u>
18. Bilanzgewinn	<u>42.532.947,25</u>	<u>40.462</u>

ELMOS Semiconductor AG, Dortmund

Anhang für 2005

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Anders als im Vorjahr werden konzerninterne Weiterbelastungen als durchlaufende Posten behandelt und in einer Position dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 - 8 Jahre, lineare Methode) vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbsterstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten einbezogen. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Der Übergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Bei den **Finanzanlagen** werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Die **unfertigen und fertigen Erzeugnisse** sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen entsprechend dem steuerrechtlichen Mindestumfang berücksichtigt werden. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschläge für noch anfallende Kosten vorgenommen.

Alle erkennbaren Risiken im **Vorratsvermögen**, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die **Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen** werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt. Die Teilwerte gemäß § 6a EStG wurden unter Verwendung der „Heubeck-Richttafeln 2005 G“ aufgrund einer Änderung der biometrischen Grundlagen neu berechnet. Es liegt ein Rechnungszinsfuß von 6 Prozent zugrunde. Eine auf Basis der Heubeck Richttafeln 1998 ermittelte Pensionsrückstellung wäre um TEUR 2 höher gewesen.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zuschüsse auf Entwicklungsleistungen werden als Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Fremdwährungen wurden zu Umrechnungskursen am Tage ihrer Entstehung oder zu niedrigeren bzw. höheren Stichtagskursen bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt.

Entwicklung des Anlagevermögens 2005

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				30.12.2001 EUR	Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte		
	31.12.2000 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR		31.12.2000 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	30.12.2001 EUR	30.12.2001 EUR	31.12.2004 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Software und Lizenzen	20.495.587,28	674.187,97	2.869.840,37	0,00	24.039.615,62	7.621.757,95	2.682.115,66	0,00	10.303.873,61	13.735.742,01	12.874
2. Geleistete Anzahlungen	4.218.137,89	1.887.173,21	-2.869.840,37	406.951,75	2.828.518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.518,98	4.218
	24.713.725,17	2.561.361,18	0,00	406.951,75	26.868.134,60	7.621.757,95	2.682.115,66	0,00	10.303.873,61	16.564.260,99	17.092
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten	12.008.645,70	413.762,40	1.358.105,87	1.418.282,00	12.362.231,97	1.959.689,14	779.286,55	0,00	2.738.975,69	9.623.256,28	10.049
2. Technische Anlagen und Maschinen	78.003.188,59	2.502.910,72	13.469.689,06	934.585,39	93.041.202,98	61.714.962,78	4.894.056,17	728.374,63	65.880.644,32	27.160.558,66	16.288
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.843.662,16	986.406,45 ¹	652.931,40	346.153,93 ¹	8.136.846,08	4.672.998,80	979.394,18 ¹	342.451,39 ¹	5.309.941,59	2.826.904,49	2.171
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.462.085,83	14.132.933,91	-15.480.726,33	0,00	8.114.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114.293,41	9.462
	106.317.582,28	18.036.013,48	0,00	2.699.021,32	121.654.574,44	68.347.650,72	6.652.736,90	1.070.826,02	73.929.561,60	47.725.012,84	37.970
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	61.593.706,59	1.706.714,20	0,00	0,00	63.300.420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300.420,79	61.594
2. Beteiligungen	557.348,77	10.403,00	0,00	0,00	567.751,77	310.000,00	0,00		310.000,00	257.751,77	247
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	992.131,21	610.799,28	0,00	0,00	1.602.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.930,49	992
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	724.344,00	927.844,69	0,00	0,00	1.652.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.188,69	724
	63.867.530,57	3.255.761,17	0,00	0,00	67.123.291,74	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	66.813.291,74	63.557
	194.898.838,02	23.853.135,83	0,00	3.105.973,07	215.646.000,78	76.279.408,67	9.334.852,56	1.070.826,02	84.543.435,21	131.102.565,57	118.619

¹ Davon fiktiver Abgang geringwertiger Wirtschaftsgüter in Höhe von EUR 183.869,21.

Angaben zum Anteilsbesitz

	Währung	Beteiligungen %	Eigenkapital in TEUR/LW	Ergebnis in Tausend
Inland				
Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt	EUR	33,33	47	107 ¹
attoSENSOR GmbH, Penzberg	EUR	45,00	14	-61 ¹
ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	173	399 ²
ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	92	1.206 ²
ELMOS Semiconductor Süd GmbH, Unterschleißheim	EUR	100,00	167	-21 ²
Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	EUR	100,00	19,9	4,1 ¹
Exedra Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	EUR	94,00	1	-2,9 ¹
GED Gärtner Electronic Design GmbH, Frankfurt/Oder	EUR	73,90	514	206
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH, Dortmund	EUR	100,00	--	-- ³
IndustrieAlpine Bauträger GmbH, München	EUR	51,00	-175	0 ¹
Mechaless Systems GmbH, Karlsruhe	EUR	51,00	866	523
Ausland				
Elmos Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	51.812	2.772
Elmos Advanced Packaging B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	225	207 ²
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	-1.040	-615 ²
ELMOS Quality Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	14.872	0,9 ²
European Semiconductor Assembly (Eurasem) B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	31.548	-0,4 ²
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited, Pretoria (Südafrika)	ZAR	67,60	275	-1.385 ⁴
EL-MOS France S.A.S., Nanterre (F)	EUR	100,00	3.373	2.270
Elmos USA Inc., Michigan (USA)	USD	100,00	--	-- ³
ELMOS California Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	233,6	99,8 ²
ELMOS N.A. Inc., Farmington Hills (USA)	USD	100,00	-4.100	-513 ²
Silicon Microstructures Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	4.381	168 ²

¹ Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2005.

² Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.

³ Es liegt bislang kein aktueller Jahresabschluss der Gesellschaft vor.

⁴ Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2004.

Forderungen und Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben bis auf einen Betrag von TEUR 1.438 (Vj. TEUR 854) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind aktivierte Forderungen auf Erstattung von verauslagten Entwicklungskosten in Höhe von TEUR 1.055 (Vj. TEUR 1.329) sowie ein Aktivwert aus einer Rückdeckungsversicherung in Höhe von TEUR 1.359 (Vj. TEUR 798) enthalten.

Eigenkapital

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2005 aus 19.412.424 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von EUR 19.412.424,00 ist voll eingezahlt.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 5. April 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 9.650.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).

Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage kann das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise in dem Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen auszuschließen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

Das Grundkapital ist um EUR 887.576,00, eingeteilt in 887.576 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00, bedingt erhöht.

Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogramms der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Mitarbeiter haben im Jahr 2005 vom Optionsrecht zum Aktienerwerb Gebrauch gemacht, was erstmals zur Ausgabe von 112.424 nennwertlosen Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 EUR, die auf den Inhaber lauten, geführt hat. Eine Kapitalerhöhung des Grundkapitals aus bedingtem Kapital zur Folge hatte. Die Kapitalrücklage erhöhte sich insgesamt um EUR 772.352,88 mit EUR 6,87 je Aktie.

Die verbleibenden Bezugsrechte haben sich zum 31. Dezember 2005 von 1.000.000 auf 887.576 verringert.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu EUR 5.000.000,00 eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus bis zum 25. April 2007 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100-prozentige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft gemäß der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 26. April 2002 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100-prozentigen Beteiligungsgesellschaften bis zum 25. April 2007 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu nominal EUR 930.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durch Ausgabe von bis zu 930.000 neuen Stückaktien ohne Nennwert mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien und nur zur Einlösung von Bezugsrechten durchgeführt, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS Semiconductor AG in dem Zeitraum vom 1. Oktober 2004 bis zum 26. April 2009 gewährt werden. Der Vorstand – und soweit es die Mitglieder des Vorstands betrifft der Aufsichtsrat – wird angewiesen, im Rahmen dieses Aktienoptionsplans 2004 bis zu 930.000 Stück Bezugsrechte auf je 1 Aktie der Gesellschaft an die unten bezeichneten Berechtigten unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in jährlichen Tranchen auszugeben. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS Semiconductor AG aus dem bedingten Kapital Bezugsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Bezugsrechte hiervon innerhalb der Ausübungsfrist Gebrauch machen. Jedes Bezugsrecht berechtigt zum Bezug einer Stückaktie ohne Nennwert mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00.

Es bestehen Bezugsrechte gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG aus einem Aktienoptionsprogramm für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter zum Erwerb von 518.157 Aktien.

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von TEUR 36.409 enthalten; im Übrigen verweisen wir auf den unten stehenden Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen wurden für Mitglieder des Vorstandes gebildet.

Die Steuerrückstellungen betreffen Ertragsteuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Tantiemen, Berufsgenossenschaft, Garantieleistungen, Lizenzen, nachkommende Rechnungen, Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufsichtsratsvergütungen und steuerliche Risiken gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine gegenüber Gesellschaftern.

Verbindlichkeitspiegel in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit				gesamt 31.12.2004
	gesamt 31.12.2005	unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.671	24.671	0	0	14.245
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	350	350	0	0	135
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.875	7.875	0	0	8.030
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	5.000	5.000	0	0	2.500
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.017	8.017	0	0	4.632
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13	13	0	0	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.295	3.885	410	0	2.252
(Vorjahr)	(2.252)	(1.315)	(937)	(0)	
- davon aus Steuern	1.000	1.000	0	0	
(Vorjahr)	(317)	(317)	(0)	(0)	317
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	697	697	0	0	
(Vorjahr)	(635)	(635)	(0)	(0)	635

Angabe von Art und Form der Sicherheiten

Die Darlehen sind durch Sicherungsübereignungen diverser angeschaffter Maschinen und Geräte sowie einer Grundschuld am gewerblichen Objekt Emil-Figge-Straße 83 / Heinrich-Hertz-Str. 1 und Joseph-von-Fraunhofer-Str. 9, 44227 Dortmund (Eigentümer: Exedra Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz) gesichert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, bis auf branchenüblich verlängerte Eigentumsvorbehalte von Lieferanten im Wesentlichen nicht besichert. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ebenfalls nicht besichert.

Derivative Finanzinstrumente

Die Gesellschaft hat einen Bonus Zinssatz-Swap für einen Nominalbetrag in Höhe von TEUR 20.000 und einer Laufzeit vom 14. April 2003 bis zum 14. April 2008 abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist der Tausch eines Festzinssatzes in Höhe von 5,250 % p. a. gegen einen variablen Zinssatz in Höhe der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR-Telerate) für 3-Monatsgelder.

Zum Stichtag wurde das Finanzderivat zum Marktwert bewertet. Es wurde eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften in Höhe von TEUR 40 gebildet.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat eine Bürgschaft für eine Kreditlinie in Höhe von USD 2.500.000,00 übernommen, welche einem verbundenen Unternehmen gewährt wurde. Zum Abschlussstichtag hat das verbundene Unternehmen die Kreditlinie in Höhe von USD 2.496.904,00 in Anspruch genommen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat Leasingverträge für das Betriebs- und Verwaltungsgebäude, für Betriebsvorrichtungen und das Parkhaus sowie für ein weiteres Bürogebäude abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2006, 2020, 2021, 2022 und 2030 erstrecken. Außerdem hat die Gesellschaft Leasingverträge für technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2007 erstrecken. Daneben bestehen Leasingverträge für den Fuhrpark, Büromaschinen und technische Anlagen und Maschinen in betriebsüblichem Umfang.

Die Gesellschaft hat einen Forschungs- und Entwicklungsvertrag sowie zur Nutzung einer Produktionslinie mit einer Laufzeit bis 2015 abgeschlossen.

Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden nichtkündbaren oben genannten Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

	<u>TEUR</u>
2006	19.146
2007	15.191
2008	10.601
2009	8.089
2010	8.045
Folgejahre	61.567

Aus erteilten Investitionsaufträgen besteht ein Bestellobligo von TEUR 7.359.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	TEUR	TEUR
- nach Sparten		
Produktion	121.515	121.871
Entwicklung	2.929	4.714
Sonstiges	467	558
Nettoumsatzerlöse	<u>124.911</u>	<u>127.143</u>
- nach Regionen		
Inland	46.885	60.119
Übrige EU-Länder	54.681	46.453
USA	16.804	11.807
Übrige Länder	6.541	8.764
Nettoumsatzerlöse	<u>124.911</u>	<u>127.143</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus Währungsdifferenzen (TEUR 483), Erträge aus Anlagenabgängen (TEUR 104), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 220), Erträge aus Projektförderungen (TEUR 291) und Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 16). Darüber hinaus werden im Wesentlichen Erträge aus privater Pkw-Nutzung, Erhöhung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung (TEUR 561), Erstattungen sonstiger Steuern (TEUR 556) und Mieten ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen aus Garantieleistungen (TEUR 1.435).

Honorare für Abschlussprüfer

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar für Abschlussprüfer gliedert sich auf in die Bereiche Abschlussprüfung (130 TEUR), sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen (24 TEUR), Steuerberatungsleistungen (110 TEUR) sowie sonstige Leistungen (5 TEUR).

Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer, Duisburg, Institutsleiter (Vorsitzender)
Dr. Burkhard Dreher, Dortmund, Diplom-Volkswirt (stellvertretender Vorsitzender)
Herbert Sporea, Altwittenbek, Kaufmann
Dr. Roland Mecklinger, Steinfeld-Hausen, Diplom-Ingenieur (bis zum 26. April 2005)
Dr. Wolfgang Heinke, Reutlingen, Diplom-Physiker (bis zum 30. September 2005)
Jutta Weber, Tarrytown, New York, Diplom-Pädagogin (seit 26. April 2005)
Jörns Haberstroh, Kerken, Diplom-Ökonom (seit 26. April 2005)
Dr. Karl-Thomas Neumann, Meine, Diplom-Ingenieur (bis zum 26. April 2005)
Dr. Peter Thoma, Unterschleißheim, (seit 1. Oktober 2005)

Herr Prof. Dr. Günter Zimmer übt zwei weitere Aufsichtsratsmandate (Siltronic AG, active photonics AG), Herr Dr. Burkhard Dreher weitere drei (Harpen AG, EKO Stahl GmbH, Vattenfall Europe Mining AG), Herr Herbert Sporea übt ein weiteres Mandat aus (Beiratsmitglied der Mechaless Systems GmbH), Herr Jörns Haberstroh weitere vier (Ehlebracht AG, 3M-Quante AG, QSC AG, Beiratsmitglied der Mechaless Systems GmbH), Herr Dr. Peter Thoma übt zwei weitere Mandate aus (Behr GmbH & Co. KG und Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG).

Vorstand

Diplom-Kaufmann Knut Siegfried Hinrichs, Glückstadt (Vorsitzender bis 1. März 2005)
Dr. rer.-nat. Klaus Weyer, Schwerte (Vorsitzender vom 9. März bis 31. Dezember 2005)
Dr. Peter Thoma, Unterschleißheim (bis zum 30. September 2005)
Diplom-Ingenieur Reinhard Senf, Iserlohn
Dr. rer.-nat. Frank Rottmann, Dortmund (seit 1. Oktober 2005)
Diplom-Physiker Dr. rer. nat. Anton Mindl, Lüdenscheid
(Vorsitzender seit 1. Januar 2006)

Gesamtbezüge des Vorstands

Die Bezüge des Vorstands teilen sich in fixe Bezüge und variable, erfolgsorientierte Bezüge auf, die sich prozentual aus dem Ergebnis des Konzerns vor Steuern ableiten. Eine langfristige Bindung wird durch die Ausgabe von Aktienoptionen erreicht, die jährlich vom Aufsichtsrat gemeinsam und in Übereinstimmung mit dem Aktienoptionsprogramm für die Mitarbeiter unterhalb des Vorstands beschlossen wird.

Demnach betragen die Bezüge des Vorstands für 2005 insgesamt TEUR 1.313. Hiervon entfällt auf den fixen Bestandteil TEUR 878 und auf den variablen Teil TEUR 435.

Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihrer Hinterbliebenen betragen im Geschäftsjahr 2005 TEUR 59. Für sie wurde eine Pensionsrückstellung in Höhe von TEUR 1.047 gebildet.

Bislang wurden von Seiten des Vorstands 140.000 Aktienoptionen, davon 20.000 in 2005 gezeichnet.

Die Mitglieder des Vorstandes halten die folgende Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Vorstand

Dr. Klaus Weyer	10.000 Stück	25.000 Optionen
Dr. Anton Mindl	4.250 Stück	0 Optionen
Dr. Frank Rottmann	0 Stück	9.200 Optionen
Reinhard Senf	1.948 Stück	40.000 Optionen

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich für 2005 insgesamt auf TEUR 97. Hierbei handelt es sich nur um fixe Bestandteile (inkl. Spesen und Auslagen).

An Aufsichtsratsmitglieder wurden in 2005 10.000 Aktienoptionen ausgegeben.

Für sonstige Dienstleistungen – insbesondere Beratungen – vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2005 TEUR 370.

Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates halten die angegebene Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Aufsichtsrat

Herbert Sporea	4.165 Stück	0 Optionen
Jörns Haberstroh	3.956 Stück	0 Optionen
Dr. Peter Thoma	9.200 Stück	40.000 Optionen
Dr. Burkhard Dreher	1.900 Stück	0 Optionen
Jutta Weber	200 Stück	0 Optionen

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte

Die folgenden meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte fanden in 2005 statt:

- EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund:
Verkauf von 870.000 Aktien zu EUR 12,50 am 25. Mai 2005
- Dr. Klaus Weyer: Verkauf von 15.000 Aktien zu EUR 12,81 am 10. August 2005;
Gewährung von 10.000 Aktienoptionen am 30. Juni 2005
- Dr. Anton Mindl: Kauf von 1.000 Aktien zu EUR 9,45 am 4. November 2005;
Kauf von 1.000 Aktien zu EUR 9,07 am 24. November 2005
- Laila Rottman (Ehefrau von Dr. Frank Rottmann):
Kauf von 246 Aktien zu EUR 9,47 am 3. November 2005
- Dr. Peter Thoma: Kauf von 2.000 Aktien zu EUR 11,92 am 20. Juni 2005;
Gewährung von 10.000 Aktienoptionen am 30. Juni 2005
- Herbert Sporea: Kauf von 1.900 Aktien zu EUR 13,13 am 12. September 2005
- Reinhard Senf: Gewährung von 10. Aktienoptionen am 30. Juni 2005

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Gewerbliche Arbeitnehmer	185	162
Angestellte (inkl. Teilzeitkräfte umgerechnet auf Vollzeit)	<u>311</u>	<u>336</u>
	<u><u>496</u></u>	<u><u>498</u></u>

Am Standort Duisburg (ELMOS Duisburg) wurden 29 Angestellte und 16 gewerbliche Arbeitnehmer beschäftigt. Die Elmos Central IT Services GmbH & Co. KG beschäftigt 29 Angestellte, Elmos Facility Management GmbH & Co. KG beschäftigt 39 Angestellte.

Konzernverhältnisse

Die ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, befindet sich im mittelbaren Mehrheitsbesitz der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, die nach § 290 Abs. 2 Nr. 2 HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Die Aufstellung eines Konzernabschlusses durch die EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, zum 31. Dezember 2005 erfolgte bislang nicht.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt (in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den Bilanzgewinn von EUR 42.532.947,77 auf neue Rechnung vorzutragen.

Erklärung gemäß § 161 AktG zum Corporate-Governance-Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, haben die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung abgegeben und den Aktionären zugänglich gemacht.

Dortmund, im März 2006

Der Vorstand

Dr. Klaus Weyer

Dr. Anton Mindl

Dr. Frank Rottmann

Reinhard Senf

LAGEBERICHT DER ELMOS SEMICONDUCTOR AG

GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte, zumeist anwendungsspezifische, mikroelektronische Schaltkreise, vornehmlich für die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2005 entfielen rund 90 Prozent vom Umsatz auf dieses Marktsegment. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat ELMOS sich eine führende Marktposition als Halbleiterhersteller im europäischen Markt für Automobilelektronik erarbeitet. Gemäß dem Marktforschungsinstitut Gartner Dataquest wird ELMOS, wie auch in den vergangenen Jahren, als die weltweite Nummer drei im Segment der ASICs (Application Specific Integrated Circuits) für den Automobilmarkt aufgeführt.

Position	Unternehmen	2004 (Mio USD)	Wachstum 2003 - 2004	Marktanteil
1	ST Microelectronics	341	8%	26%
2	NEC Electronics	200	29%	16%
3	ELMOS Semiconductor	146	25%	11%
4	AMI Semiconductor	130	26%	10%
5	Melexis	84	38%	7%
	Sonstige	399	-11%	30%
	Gesamt	1.300	8%	100%

ELMOS-Chips werden von nahezu allen europäischen Fahrzeugherstellern eingesetzt. Stetig wachsende Anforderungen an die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und die Umweltverträglichkeit eines Kraftfahrzeugs sowie an Sicherheit und Komfort führen zu immer mehr Elektronik im Auto. Halbleiterbausteine von ELMOS sind ideal geeignet, solche Systeme kompakt, zuverlässig und kostengünstig aufzubauen.

Seit mehr als 20 Jahren bedient ELMOS geschützte Nischenmärkte mit eigenem Know-how. Es ist die Strategie, zum einen durch eine konsequent an den Marktbedürfnissen optimierte Fertigungstechnologie und zum anderen durch die kundenspezifische Produktentwicklung zu überzeugen. So entwickelt ELMOS in der Regel Produkte im Kundenauftrag für eine spezielle Anwendung und produziert diese exklusiv für diesen Kunden. ELMOS ist bestrebt, als kompetenter Partner der Kunden mit maßgeschneiderten, integrierten Schaltungen ein profitables Geschäft zu betreiben und die eigenen Marktanteile zu erhöhen.

Neben den kundenspezifischen Schaltkreisen, die etwa 90 Prozent der Produkte umfassen, verfügt ELMOS zudem über ein Portfolio von anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) sowie von mikromechanischen Sensoren aus der Produktion der Tochtergesellschaft Silicon Microstructures Inc. (SMI) in Milpitas, Kalifornien, USA. SMI entwickelt, produziert und vertreibt mikromechanische Bauelemente (MEMS) und zählt zu den Technologieführern im Bereich der hochpräzisen Drucksensoren in Silizium. Außer Drucksensoren entwickelt SMI Sensoren für Beschleunigung und Drehbewegungen, die speziell für die Automobilindustrie geeignet sind. Mit einer eigenen Fertigung in Kalifornien verfügt SMI über stabile Serienfertigungseinrichtungen und -fähigkeiten. Darüber hinaus unterstützt die produzierende Tochterfirma ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELMOS AP) mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, das Technologie- und Produktportfolio. ELMOS AP entwickelt und fertigt Gehäuse für elektronische Halbleiterkomponenten und Sensoren. Neben Standardgehäusen gemäß JEDEC-Normen gehören kunden- und applikationsspezifische Spezialgehäuse, die sich teilweise durch patentiertes Know-how vom Wettbewerb unterscheiden, zum Produktportfolio. Die Fabrik in Nijmegen entspricht dem modernsten Stand der Technik.

ELMOS produziert alle ASICs selbst in einer eigenen Produktionsstätte für Halbleiterbauelemente (Wafer-Fab) in Dortmund. Sowohl durch die automobil-gerechte Hochvolt-CMOS Technologie als auch durch die systemgerechte Integration von analogen und digitalen Funktionen mit On-Chip Treiberleistungen unterscheidet sich ELMOS von den meisten Wettbewerbern.

Zudem wird die im Berichtsjahr neu geschaffene Einheit ELMOS Microsystems die Entwicklung und Vermarktung von anwendungsspezifischen, mechatronischen Modulen forcieren. Diese Module kombinieren die Fähigkeiten der drei produzierenden Unternehmen der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen, mikromechanischen Sensoren und funktionalem Gehäuse. Damit kann das Unternehmen kostengünstige Systemlösungen, wie beispielsweise ko-integrierte Drucksensoren, realisieren.

Automobile Neuprojekte benötigen in der Regel drei bis vier Jahre Entwicklungszeit, bevor sie für etwa fünf Jahre in Serie produziert werden. Teilweise verlängert sich diese Produktionszeit erheblich, wenn Autohersteller eine ähnliche technische Plattform in einer Familie von neuen Modellen einsetzen. Zum Zeitpunkt des Gewinns eines Neuprojekts werden in der Regel die Preise in Abhängigkeit von geplanten Mengen für die gesamte Projektlaufzeit kalkuliert.

Neben dem automobilen Markt ist ELMOS außerdem im Industrie- und Konsumbereich tätig und liefert kundenspezifische Schaltkreise für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Fotoapparaten, Installations- und Gebäudetechnik und Maschinensteuerungen. Diese nicht automobilen Märkte haben im vergangenen Jahr wie in den Vorjahren rund zehn Prozent des Umsatzes ausgemacht.

STRATEGIE

ELMOS hat im Berichtsjahr und zu Beginn des Jahres ihre Strategie wie folgt formuliert und erweitert:

► **Fokussierung auf kundenspezifische, automobiler Applikationen**

ELMOS hat jahrzehnte lange Erfahrung im Bereich der automobilen Halbleiter. Diese Stärke wird ELMOS nutzen, um zusammen mit den Assets der eigenen Produktion und Technologie, die als Voraussetzung für das erfolgreiche Bestehen im automobilen Markt gesehen wird, weiterhin kundenspezifische automobiler Anwendungen entwickeln. Darüber hinaus wird ELMOS durch die Expertise der neuen Vorstandsmitglieder neue Anwendungen im Markt adressieren können.

► **Ausbau des Vertriebs der Standardprodukte (ASSPs)**

ELMOS wird in Zukunft vermehrt Standardprodukte produzieren und vertreiben. Auf Basis der gefertigten kundenspezifischen Schaltkreise wird ELMOS anhand der automobiler Expertise in anderen Anwendungsbereichen Produkte entwickeln und diese einem breiteren Kundenkreis zur Verfügung stellen. Insbesondere in den USA sind Standardprodukte für bestimmte Anwendungen gefragt, da höhere Projektvolumina bei einer geringeren Kundenzahl zur Disposition stehen. Zu diesem Zweck hat ELMOS in 2005 seinen Vertrieb umstrukturiert, um mit dem neu geschaffenen Bereich „Applikationen und Systeme“ gezielt die Kunden in ihren Märkten ansprechen zu können.

► **Vermarktung von Mehr-Chip Lösungen**

Mit der Fähigkeit, Mikrosysteme bestehend aus ASICs und MEMS in einem kundenspezifischen Package zu entwickeln und zu produzieren, grenzt sich ELMOS klar von seinen Wettbewerbern ab und offeriert seinen

Kunden einen einzigartigen Vorteil. Nur sehr wenige Unternehmen verfügen über derartige Technologien im eigenen Hause. Dadurch können neuartige Anwendungsgebiete, insbesondere intelligente Sensorsatelliten, adressiert werden. Die interne Einheit ELMOSS Microsystems ist damit beauftragt, die Vermarktung dieser Mikrosysteme für den ELMOSS Konzern voranzutreiben.

► **Integration von Fremdsilizium in eigene Systemlösungen**

Künftig soll die Eigenfertigung auf Produkte mit speziellen Anforderungen an Design und Technologie beschränkt werden. Infolgedessen werden in Zukunft Bauelemente zugekauft, die optimaler in von ELMOSS nicht angebotenen Technologien gefertigt werden können (z.B. 0,25µm). Diese werden aber von zahlreichen Foundries offeriert. Dank der technischen Möglichkeiten von ELMOSS Advanced Packaging können so eigene und fremdbezogene Bauelemente in funktionalen Gehäusen als Multi-Chip-Modul zusammen gefasst werden. Die Fähigkeit und Bereitschaft, Bauteile von externen Lieferanten zu integrieren, eröffnet ein großes Gebiet von neuen Anwendungen. Damit wird die Eigenproduktion in den Fällen sinnvoll ergänzt, wo es technologisch oder aus Kostengesichtspunkten angebracht ist. Gleichzeitig kann der Bezug von externen Bauteilen dazu beitragen, die erforderlichen Investitionen zur Bereitstellung von Kapazität zu reduzieren.

► **Adressierung zusätzlicher Märkte**

Der Automobilmarkt ist aufgrund der langen Entwicklungs- und Produktionszeiten für die Einführung von Innovationen nicht optimal geeignet. Um dennoch innovative Ideen schnell in den Markt bringen zu können, will ELMOSS die existierende Kundenbasis im Konsumbereich ausbauen. Dabei wird insbesondere auf ein Agieren aus einer patentgeschützten Position heraus geachtet. Für nicht-automobile Märkte, d.h. Industrie- und Konsummärkte, strebt ELMOSS mittelfristig einen Umsatzanteil von 20 bis 30 Prozent des Gesamtumsatzes an.

RAHMENBEDINGUNGEN

Automobiler Halbleitermarkt

Der für ELMOSS relevante Markt ist der der Halbleiterchips für die Automobilindustrie. Dieser Markt stellt einen Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie dar. Er umfasst weltweit einen Anteil von rund acht Prozent des gesamten Halbleitermarkts. Bedingt durch den Einfluss der relativ konstanten Automobilproduktion und des zunehmenden Anteils der Elektronik im Fahrzeug weist der automobiler Halbleitermarkt eine deutlich höhere Stabilität auf als der globale Halbleitermarkt, welcher hauptsächlich durch die Entwicklungen bei Speicher- und Kommunikationschips geprägt ist. Es wird erwartet, dass der Wertanteil der Elektroniksysteme je Fahrzeug von heute 25 Prozent bis 2010 auf rund 35 Prozent ansteigen wird. Elektronik und Mikroelektronik für den Automobileinsatz wuchsen in der Vergangenheit und wachsen auch langfristig um ein Vielfaches schneller als die Zahl der neu produzierten Kraftfahrzeuge. Ein Ende dieses Trends ist nicht vor Mitte der 2020er Jahre zu erwarten.

Spezielle Differenzierungsmerkmale des automobilen Halbleitermarkts sind die für die Halbleiterbranche untypisch lange Produktlebensdauer und die dadurch bedingten langen Lieferzeiträume von teilweise mehr als zehn Jahren. Zudem unterscheidet sich der Markt durch langfristige Kunden-Lieferanten-Beziehungen und die sehr hohen Qualitätsanforderungen.

Der weltweite Markt der automobilen Halbleiter betrug im Jahr 2004 16,8 Milliarden US-Dollar. Für die kommenden Jahre sagen Experten ein Wachstum für den automobilen Halbleitermarkt von acht bis zehn Prozent pro Jahr voraus. So erwartet der Zentralverband der Elektronikindustrie, dass der Markt bis 2009 auf 25,8 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.

Der von ELMOS maßgeblich adressierte Markt ist wiederum nur ein Teil des automobilen Halbleitermarkts, nämlich der vorwiegend kundenspezifischen Halbleiter, der sogenannten ASICs. Wegen der vergleichsweise geringen Jahresstückzahlen stehen diese ASICs nicht im Fokus der großen Halbleiterhersteller, welche Auslastung für ihre großen Produktionskapazitäten suchen. Weitere Differenzierungsmerkmale des ASIC-Geschäftes sind sehr enge Lieferbeziehungen des Kunden zu einem einzelnen ASIC-Hersteller, die aus dem Wunsch des Kunden nach Schutz des eigenen Know-hows entstehen. Wettbewerber der ELMOS sind bei typischen ASIC-Projekten mit mittleren Stückzahlen Firmen ähnlicher Größe wie AMI Semiconductor, Melexis, austria micro systems und Micronas. Bei sehr großen Stückzahlen steht ELMOS auch in Konkurrenz zu Großproduzenten wie Infineon, ST Microelectronics und Freescale.

Wirtschaftliches Umfeld

Im Jahr 2005 hat sich eine deutliche Veränderung des Marktes vollzogen. Die Konsolidierung und Verdichtung im Automobilmarkt hält unvermindert an, die Anzahl der Zulieferer sinkt. Die durchschnittlichen Volumina der Projekte steigen an und damit auch der Preisdruck. Dieser wird von den Automobilherstellern in Form von Kostensenkungsprogrammen an die sogenannten „Tier 1“ Hersteller, die Zulieferer der ersten Reihe, weitergegeben. Diese reichen den Preisdruck bei der Verhandlung von Neuprojekten an ihre Zulieferer weiter.

Da die Produktentwicklungszeiten in der Automobilindustrie immer kürzer werden sollen, steigt auch der Termindruck an. Durch eine nach langfristigen Verhandlungen verspätete Auftragsvergabe wird die Situation häufig noch verschärft. Andererseits können selbst kleinste Überschreitungen des Projektendtermins dazu führen, dass ein Auftrag nicht in die Produktion überführt werden kann.

Auch bei der Übernahme der Entwicklungskosten ergaben sich Veränderungen. Früher hat der Kunde in der Regel rund die Hälfte der Entwicklungskosten übernommen. Heute ist die Bereitschaft zur Übernahme von Entwicklungskosten durch den Kunden stark rückläufig, was sich durch den härteren Wettbewerb erklären lässt. Damit wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Kunde ein Projekt abbricht, z.B. weil er den Auftrag von seinem Endkunden verloren hat.

Besonders bei sehr großen Projekten verlangt der Kunde die Umlage der Entwicklungskosten in die Serie. Zudem sind hier häufiger parallele Entwicklungen durch zwei Lieferanten – im Gegensatz zum früher üblichen Single-Sourcing – anzutreffen. Eine Folge davon und des starken Kostendrucks ist, dass heutzutage ein Wechsel des Zulieferers bei derartigen Projekten sogar während der Serienproduktion eines Fahrzeugs möglich ist.

GESCHÄFTSVERLAUF IM JAHR 2005

Das Jahr 2005 spiegelt die oben genannten Veränderungen der Rahmenbedingungen wider. ELMOS ist mit Optimismus in das Jahr gestartet, hat aber im Verlauf einige Rückschläge hinnehmen müssen. Dabei verlief diese Entwicklung nicht kontinuierlich. Das erste Quartal zeigte zwar einige Schwierigkeiten auf, jedoch gestaltete sich insbesondere das zweite Quartal sehr erfolgreich. Ein erheblicher Umsatzeinbruch im dritten Quartal machte aber die Hoffnung auf das Erreichen der Jahresziele zunichte und zwang zu einer deutlichen Zurücknahme der Prognose im September. Der Auftragseingang im Laufe des Berichtsjahres reflektierte den problematischen Umsatzverlauf. Erst das vierte Quartal zeigte die Rückkehr zu einem stabilen Auftragseingang. Diese negative Entwicklung wurde auf die folgenden Effekte zurückgeführt:

- ▶ **Schnellerer Auslauf von Altprodukten:** Im Jahr 2005 wurde der planmäßige Ausfall einer Reihe von Altprodukten erwartet. Zu einem wesentlichen Anteil war dies die Folge des Modellwechsels der 3er Baureihe von BMW sowie einer technischen Veränderung innerhalb der laufenden 5er Reihe. Dieser Auslauf erfolgte weitaus schneller als

erwartet, da sich die Lagerbestände der Kunden als höher erwiesen. Offenbar hatten einige Kunden Engpässe in der Bauteileversorgung befürchtet und deshalb interne Vorräte aufgebaut. Der von den neuen Produkten generierte Umsatz reichte zwar aus, die wegfallenden Umsatzerlöse mit den Altprodukten zu ersetzen, ermöglichte aber nur ein mäßiges Wachstum.

- ▶ Änderungen im Produktmix: Als Folge des schnelleren Auslaufs von Altprodukten weist das heutige Produktportfolio einen weitaus höheren Anteil an Neuprodukten als in den Vorjahren aus. Neue Produkte weisen eine deutlich höhere Funktionalität auf und erfordern komplexere Prozesstechnologien. Damit stellt auch der starke Umbruch im Produktmix zusätzlich zum geringer als geplanten Umsatz eine Belastung für die Margen dar.
- ▶ Verschiebungen von Projekten: Anders als früher, als die Zeitpläne noch sehr fest standen, sind heute verstärkt Tendenzen zu beobachten, dass die Starttermine für die Serienproduktion kundenseitig verschoben werden. So sind einige der zahlreichen Entwicklungsprojekte durch von Kunden verursachte, aber auch durch von ELMOS zu vertretende Verzögerungen nicht planmäßig fertiggestellt worden.
- ▶ Stornierungen von einigen signifikanten Projekten: In der letzten Zeit zeigt sich eine Tendenz zu mehr gestoppten Projekten, d.h. dass nach erfolgter Entwicklung Projekte nicht zu Umsatz geführt haben. Teilweise ist dies begründet durch die schwierige wirtschaftliche Lage des Kunden bzw. des automobilen Endkunden. Dies betraf auch einige großvolumige Projekte, was sich negativ auf den Umsatz auswirkt.
- ▶ Konjunkturschwäche im ersten Halbjahr: Bedingt durch die Schwäche einiger amerikanischer Automobilhersteller wurden im Frühjahr verschiedene Entwicklungsprojekte verzögert beziehungsweise abgesagt. Hinzu kam die zögerliche Absatzentwicklung bei deutschen Fahrzeugen, unter anderem im Zusammenhang mit der Feinstaubdiskussion.

Um in Zukunft solche negativen Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und die Einflüsse auf die Geschäftsentwicklung zu minimieren, wurde im Frühsommer eine Initiative zur Verbesserung der Planungssicherheit, zur beschleunigten Bereitstellung von neuen Prozesstechnologien und zur intensiveren Betreuung der Entwicklungsprojekte gestartet. Dazu hat ELMOS zusätzliche Ressourcen, sowohl für die Technologieentwicklung als auch für die Produktentwicklung, bereitgestellt. Auch die Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg mit dem Ziel der möglichst schnellen Inangangsetzung der zweiten Produktionslinie ist vorangetrieben worden. Damit verbunden waren zusätzliche Kosten.

Schließlich ist das Jahr 2005 neben den wirtschaftlichen Umbrüchen und Aufbrüchen auch durch wesentliche personelle Veränderungen im Vorstand geprägt. Mit dem Tod des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Knut Hinrichs im März 2005 wurde die Verjüngung und Neubesetzung des Vorstands früher als geplant eingeleitet. Im Oktober 2005 traten Dr. Anton Mindl als designierter Vorsitzender und Dr. Frank Rottmann als Nachfolger von Dr. Peter Thoma, der sein Amt planmäßig nach fünfjähriger Amtszeit zum 30. September 2005 niederlegte, als neue Mitglieder in den Vorstand ein. Nachdem Dr. Klaus Weyer als Interimsvorstandsvorsitzender für den Rest des Jahres 2005 fungierte, trat Dr. Anton Mindl seine Nachfolge als Vorstandsvorsitzender zum 1. Januar 2006 an.

PRODUKTION

Die 2005 an Kunden ausgelieferten ASICs und ASSPs sind ausschließlich am Hauptstandort Dortmund auf der 150mm-Wafer-Linie (entspricht 6-Zoll) produziert worden. Diese wurde im Berichtsjahr weiter planmäßig ausgebaut,

um für die nächsten Technologie-Generationen und den steigenden Kapazitätsbedarf der Produktion vorbereitet zu sein. Obwohl in 2005 stückzahlmäßig nicht wesentlich mehr Chips produziert wurden als im Jahr zuvor, sind jedoch die Anforderungen an die Produkte und damit deren Komplexität, gemessen an der Anzahl der Masken bzw. Layer, erheblich gestiegen. Daher ist auch die Erweiterung der Kapazitäten zur Beseitigung von Bottlenecks notwendig geworden. Die Produktionsräume und -anlagen am Standort Dortmund sind für Prozesse mit Strukturbreiten bis 0,35 Mikrometer auf den modernsten Stand der Technik ausgelegt. Zum Jahresende 2005 lag die Maschinenkapazität unverändert gegenüber dem Vorjahr bei rund 450 Waferstarts pro Tag; die Ausnutzung übertraf mit 400 Waferstarts pro Tag leicht das Niveau des Vorjahres (rund 380 Waferstarts). Die absolute Waferkapazität ist nicht gestiegen, da die Waferkomplexität (Fototechnikebenen) sich deutlich erhöht hat. Insgesamt wurden in 2005 über 130.000 Wafer (2004: mehr als 120.000 Wafer) gefertigt. Die fast gleich gebliebene Kapazität (gemessen in Waferstarts pro Tag) belegt, dass nicht die Menge, sondern der Anstieg der Komplexität der Produkte der bestimmende Faktor für die Produktion im Jahr 2005 war.

Die Kapazität der bestehenden Produktionslinie in Dortmund kann nach wie vor durch Rekrutierung weiterer Mitarbeiter und durch weitere Investitionen in Maschinen und Ausbau von Räumen erweitert werden. Im Jahr 2005 wurden die wesentlichen Schritte zur Sicherung der Kapazität für die nächsten Jahre fixiert. Dazu gehört zum einen der Beginn des Ausbaus der Produktion am Standort Dortmund mit den Arbeiten am vierten Bauabschnitt, der neue Reinraumflächen für die Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2006 verfügbar machen wird. Dieser Baukörper ist zunächst für eine Erweiterung des Backends ab Mitte 2006 vorgesehen und kann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auch Raum für die Erweiterung des Frontends schaffen.

Der zweite Baustein zur Kapazitätssicherung ist die in 2005 vertraglich gesicherte Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg. ELMOS hat in 2005 den Betrieb der dort existenten 200mm-Wafer-Linie aufgenommen und die Qualifikation erster Produkte initiiert. Die heutige Planung sieht vor, dass Mitte 2006 die ersten in Duisburg gefertigten Produkte an Kunden geliefert werden.

Der behutsame Ausbau der Kapazitäten in Dortmund, die neue Produktionsstätte in Duisburg sowie der zukünftige Fremdbezug stellen die erforderliche Fertigungskapazität für die mittelfristige Zukunft der ELMOS sicher.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die nicht automobilen Märkte dienen der ELMOS-Gruppe als Innovationstreiber. Hohe Anforderungen der Automobilindustrie an Qualität und Zuverlässigkeit der Halbleiter sowie lange Entwicklungszeiten bis zur Serienproduktion erschweren rasche Weiterentwicklungen von Halbleitertechnologien. Die schnelllebigere Märkte mit kurzfristigen Produktlebenszyklen und anders gearteten Anforderungen an Geschwindigkeit und Speichergröße führen dazu, dass dort neueste Technologien in kürzester Zeit und schneller Abfolge etabliert werden. Die Technologien für diese innovationstreibenden Märkte werden erst mit deutlichem zeitlichen Verzug auch im automobilen Halbleitermarkt eingesetzt. Mit der Entscheidung, in Zukunft fremdbezogene Bauelemente aus diesen schnelllebigere Märkte einzusetzen, wird das Produktportfolio der ELMOS entscheidend erweitert und ein zusätzlicher Treiber für die technologische Weiterentwicklung bei ELMOS erschlossen.

Im Berichtsjahr war ein klarer Schwerpunkt der Aktivitäten in Forschung und Entwicklung der Transfer des 0,8µm-Prozesses an den Standort Duisburg. Zum Jahresende wurden die ersten Lose für Qualifikationsmuster der ersten beiden transferierten Produkte dort eingesteuert. Die Aktivitäten zur Entwicklung neuer Prozesstechnologien mit kleineren Strukturgrößen und Flash-Option werden in Zukunft konsequenterweise in Duisburg direkt innerhalb der 200mm Linie durchgeführt, da damit der größte Kostenvorteil zu erreichen ist. Diese Arbeiten zur Entwicklung der 0,35µm-Technologie machen einen weiteren Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung aus. Damit

verfolgt ELMOS die Strategie, durch eigene Prozesstechnologien innovative und wettbewerbsüberlegene Lösungen anbieten zu können und gleichzeitig die Vorteile aus der Kombination dieser eigenen Produkte mit hochintegrierten Bauelementen aus Foundries zu nutzen.

Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entfällt der mit Abstand größere Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung neuer Produkte. Wie schon in der Vergangenheit haben im Jahr 2005 die Kunden weiterhin Druck dahingehend ausgeübt, dass der Lieferant die Kosten für Forschung und Entwicklung eines ASICs übernimmt. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Produktentwicklungskosten vom ASIC-Lieferanten, das heißt ELMOS, vorfinanziert werden muss und sich erst über die Serienstückfertigung amortisieren kann. Darüber hinaus haben die Automobilhersteller weiterhin forciert, dass ihre Zulieferer Verantwortung für Systeme übernehmen, welche diese ihrerseits an die Zulieferer der zweiten Reihe weitergeben. Diese Aufgaben werden somit zunehmend von ELMOS übernommen.

MITARBEITER

Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem Maße vom Know-how der Mitarbeiter. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für das Wachstum und die Innovationskraft. Am Standort Dortmund in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, kann ELMOS auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im näheren Umkreis befinden sich mehr als fünfzig Universitäten und Hochschulen. Schon seit der Gründung kooperiert ELMOS eng mit diesen und genießt als einziger Halbleiterhersteller der Region eine Ausnahmestellung.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt in Dortmund vertrauensvoll und mittels einer Mitarbeitervertretung mit selbst gegebener Satzung. In zahlreichen Ausschüssen werden die Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhältnis zur Geschäftsleitung besprochen und geregelt. So gibt es Ausschüsse für soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterförderung und Wirtschaft.

Mitarbeiterbeteiligung / Aktienoptionsprogramme

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit über Aktienoptionsprogramme am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Diese Programme sehen die Ausgabe von Aktienoptionen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb des Vorstands und zu identischen Bedingungen an den Vorstand vor. Für Tranchen seit 2004 gilt für den Vorstand als zusätzliche Bedingung eine Begrenzung der Wertsteigerung. Für die Vorstandsmitglieder dienen die Aktienoptionen gleichzeitig als variable Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung.

Im Dezember 2005 hat der Aufsichtsrat zunächst kein neues Aktienoptionsprogramm beschlossen. Vor dem Hintergrund des im Vergleich zur früheren Behandlung nach US-GAAP höheren Aufwands, der sich nach der von IFRS 2 vorgeschriebenen Bilanzierung nach dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) ermittelt, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, dass gegebenenfalls andere Maßnahmen zur Incentivierung von Mitarbeitern und Vorständen eingesetzt werden sollen. Derzeit werden alternative Programme eruiert.

QUALITÄT, SICHERHEIT UND UMWELTSCHUTZ

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent ihre Null-Fehler-Strategie um und erzielt damit ein hervorragendes automobilgerechtes Qualitätsniveau. Regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Werkzeuge, die Betreuung der Serienprodukte von der Entwicklung bis zur Fertigung, ständige Analysen und statistische Verfahren ermöglichen das hohe Qualitätsniveau. Interne Labore prüfen nicht nur mögliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch sensor- und gehäusespezifische Merkmale.

ELMOS betreibt seit Mitte der Neunziger Jahre ein Qualitätsmanagementsystem, das alljährlich gemäß den Anforderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 auditiert wird. Diese Normen wurden inzwischen in der ISO/TS 16949: 2002, die weltweite Gültigkeit hat, zusammengefasst. ELMOS Dortmund, ELMOS North America, ELMOS France und GED wurden auch in 2005 gemäß der neuen Norm auditiert und zertifiziert.

Arbeitsicherheit und Umweltschutz sind neben der Qualität der Produkte und der Wirtschaftlichkeit als gleichrangige Unternehmensziele festgelegt. Zu den Grundsätzen der Umweltpolitik bei ELMOS zählen Rechtskonformität, Minimierung von Umweltbelastungen, Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter, Umweltschutz-Management, kontinuierliche Verbesserung und Kommunikation.

Das Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001 wurde am Standort Dortmund in 2003 (durch den TÜV Rheinland) zertifiziert und in den nachfolgenden Jahren 2004 und 2005 durch Überwachungsaudits ohne Abweichungen bestätigt. Die Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den Umweltschutz systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim Umweltmanagement besonderen Wert auf eine effektive Prävention sowie eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen.

Neben der Veröffentlichung des Umweltberichts für 2004, der ausführlich über die umweltrelevanten Tätigkeiten, die davon ausgehenden Umweltauswirkungen sowie über die Organisation der Arbeitsicherheit informiert, hat ELMOS in 2005 erstmalig seine hohen sozialen, ökologischen und ökonomischen Ansprüche in einem „Kodex des verantwortungsvollen Handelns“ zusammengefasst. Der Kodex berichtet detailliert über die Verantwortung für das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Umwelt und die Gesellschaft. Dieser Verhaltenskodex richtet sich an alle Führungskräfte und Mitarbeiter des ELMOS-Konzerns. Damit wollen wir – für jedermann nachvollziehbar – zu einwandfreiem Verhalten anhalten und mehr Transparenz schaffen.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9 Prozent größter Einzelaktionär der ELMOS Semiconductor AG. Daher hat der Vorstand gemäß § 312 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklärung gemäß § 312 Abs. 3 AktG abschließt:

„Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen und die Maßnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Nachteile im Sinne von § 312 AktG haben sich aus den Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für uns nicht ergeben.“

ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG nach HGB

<i>In Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben</i>	2004	2005	Veränderung
Umsatzerlöse	127,1	124,9	-1,8%
Materialaufwand	41,1	47,6	15,6%
Personalaufwand	28,2	30,2	7,3%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6,9	9,3	35,4%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23,7	8,1	-65,9%
Jahresüberschuss	14,4	6,1	-57,5%

UMSATZ- UND ERTRAGSENTWICKLUNG

Das Jahr 2005 war schwierig für ELMOS. Der Umsatz sank um 1,8 Prozent auf 124,9 Millionen Euro. Dies ist im Wesentlichen auf den Mitte 2005 zu ELMOS Advanced Packaging verlagerten Versand zurückzuführen.

Der Materialaufwand ist um 15,6 Prozent auf 47,6 Millionen Euro stark gestiegen und ist bedingt durch geänderten Produktmix und vermehrten bezogenen Leistungen. Der Personalaufwand hat sich aufgrund der gestiegenen Anzahl an Mitarbeitern auf 30,2 Millionen Euro erhöht. Bedingt durch den Anstieg der Aufwandspositionen hat sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 23,7 Millionen Euro um –65,9 Prozent auf 8,1 Millionen Euro rückläufig entwickelt. In ähnlichem Ausmaß hat sich der Jahresüberschuss reduziert.

FINANZLAGE

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemäß HGB

<i>In Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben</i>	2004	2005	Veränderung
Periodenergebnis	14,4	6,1	-57,5%
Abschreibungen/Zuschreibungen	6,3	9,3	48,7%
Veränderungen von Rückstellungen und Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen	3,1	-2,0	n.a.
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-5,2	-11,7	123,8%
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	3,3	8,0	141,2%
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	21,9	9,8	124,0%
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-21,0	-21,7	3,6%
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-4,2	7,3	n.a.
Abnahme / Zunahme der Finanzmittel	-3,3	-4,7	41,7%
Finanzmittel am Ende der Periode	11,9	7,2	-39,2%

Der deutlich niedrigere Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist auf den im Vergleich zum Vorjahr geringeren Jahresüberschuss zurückzuführen. Zusätzlich sind der Rückgang der kurzfristigen Rückstellungen sowie der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände die Hauptfaktoren für den niedrigeren Cash Flow aus der

laufenden Geschäftstätigkeit. Da die aus der laufenden Geschäftstätigkeit generierten Finanzmittel nicht ausreichen, um die für die Investitionstätigkeit erforderlichen Mittel bereitzustellen, wurde im Wesentlichen mittels Aufnahme von kurzfristigen Verbindlichkeiten der Finanzbedarf gedeckt.

VERMÖGENSLAGE

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemäß HGB

<i>In Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben</i>	31.12.2004	31.12.2005	Veränderung
Anlagevermögen	118,6	131,1	10,5%
Langfristige Forderungen	0,9	1,4	68,4%
Vorräte	19,9	21,5	7,6%
Kurzfristige Forderungen	31,5	41,6	32,3%
Flüssige Mittel	12,6	7,9	-37,2%
Übrige Aktiva	2,0	1,4	-30,7%
Eigenkapital	143,9	146,8	2,1%
Langfristige Verbindlichkeiten	3,2	2,9	-9,9%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	38,4	55,2	43,8%
Bilanzsumme	185,5	204,9	10,1%

Die Bilanzsumme ist von 185,5 Millionen Euro am 31. Dezember 2004 auf 204,9 Millionen Euro am 31. Dezember 2005 gestiegen. Diese Zunahme ist durch zwei wesentliche Effekte beeinflusst: zum einen ist das Anlagevermögen, bedingt durch die getätigten Investitionen, gestiegen. Zum anderen haben die kurzfristigen Forderungen aufgrund von erhöhten kurzfristigen Ausleihungen und Steuererstattungsansprüchen zugenommen. Auf der Passivseite verzeichneten die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einer Zunahme von 16,8 Millionen Euro den höchsten Anstieg. Die Eigenkapitalquote reduzierte sich auf 71,7 Prozent. Barmittel sanken zum 31. Dezember 2005 auf 7,9 Millionen Euro (im Vergleich zu 12,6 Millionen Euro am 31. Dezember 2004).

RISIKOBERICHT

RISIKOMANAGEMENTSYSTEM

Die ELMOS Semiconductor AG hat im Berichtsjahr das in 2002 eingerichtete umfassende Risikomanagementsystem, das die Anforderungen des §91 (2) AktG erfüllt, Schritt für Schritt auf die Unternehmen im Konzern angewendet und weiter verfeinert. Das Risikomanagementsystem von ELMOS und seine Anwendung wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresende kritisch auf Konformität mit den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und Aktiengesetzes geprüft und für geeignet befunden, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen. Es sieht die regelmäßige Erfassung und Bewertung von neuen und bekannten Risiken durch die verantwortlichen Mitarbeiter vor und legt ein geschlossenes Reporting-System fest. Die Unternehmensbereiche der ELMOS-Gruppe berichten auf monatlicher Basis über die finanzielle und operative Entwicklung. Durch diese Maßnahmen werden Vorstand und Aufsichtsrat regelmäßig und frühzeitig über die Risikolage informiert und können geeignete Maßnahmen zur Risikominderung beziehungsweise -vermeidung oder -abwehr beschließen. Das Risikomanagementsystem wird auch zukünftig kontinuierlich erweitert und entsprechend sich ändernder Rahmenbedingungen verbessert werden.

Es ist die Strategie von ELMOS, Zins- und Währungsrisiken durch geeignete Instrumente, wie entsprechende Derivatprodukte, abzusichern. ELMOS geht dabei zeitweise Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Transaktionen in Fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem das Risiko besteht. Diese Kurssicherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Ertragslage. ELMOS beteiligt sich nicht an Spekulationsgeschäften.

ABHÄNGIGKEIT VON DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Das Kerngeschäft von ELMOS steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Automobilindustrie nach ASICs. Rund 90 Prozent des Umsatzes wird mit Halbleitern für die Automobilelektronik erwirtschaftet. Diese Nachfrage ist einerseits abhängig von den produzierten Stückzahlen an Fahrzeugen und wird andererseits von dem anhaltenden Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Durch die Zunahme an elektronischer Ausrüstung im Auto steigen die Stückzahlen an verkauften ASICs auch dann, wenn die Zahl der produzierten PKWs stagniert oder abnimmt.

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von Zusammenschlüssen von Systemherstellern, restriktiver Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren, beachtlichen Schwankungen. Die ELMOS-Kundenstruktur lässt sicherlich eine gewisse Abhängigkeit von einigen großen Automobilzulieferern erkennen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der von einem Kunden generierte Umsatz in der Regel nicht durch ein Produkt entsteht, das heißt auch überlappende Lebenszyklen damit verbunden sind. Aufgrund der Bedeutung und der Spezialisierung der ASICs von ELMOS für das Produkt des Automobilzulieferers handelt es sich bei der Beziehung zum Kunden um eine gegenseitige Abhängigkeit. Daher können größere Umsatzvolumina mit einigen Großkunden Zeichen für eine langfristige Kundenbeziehung mit entsprechenden Umsatzpotenzialen sein. Es kommt nur bei sehr großen Volumina vor, dass ein und derselbe ASIC an zwei Lieferanten gleichzeitig vergeben wird, da die Automobilzulieferer selbst unter erheblichem Kostendruck stehen und die gleichzeitige Entwicklung eines ASICs durch zwei Lieferanten erhebliche Mehrkosten zunächst im Entwicklungsbereich und später wegen der geringeren Stückzahlen für den einzelnen ASIC-Lieferanten im Fertigungsbereich bedeuten.

WETTBEWERB

Sowohl im Automobil- wie auch im Konsum- und Industriebereich agiert ELMOS stets aus geschützter Position, entweder technologiebedingt oder aufgrund speziellen Anwendungs-Know-hows. Eine Vielzahl von Wettbewerbern im Halbleitermarkt für automobiler Anwendungen bietet ähnliche Produkte wie ELMOS auf vergleichbarer technologischer Grundlage an. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass große Halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz im automobilen Halbleitermarkt tätig sind, in Zukunft versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Dies geschieht insbesondere in Phasen, in denen das klassische Halbleitergeschäft in den Bereichen Speicherchips und Telekommunikation Rückgänge zu verzeichnen hat. Da diese Großproduzenten aus Rentabilitätsgründen sich oftmals auf großvolumige Projekte fokussieren müssen, ist ihr Engagement im Nischenmarkt der kundenspezifischen Schaltungen relativ gering. Damit erscheint das Risiko für ELMOS vergleichsweise gering. Allerdings akquiriert ELMOS in letzter Zeit vermehrt großvolumigere Aufträge. Dadurch wird ELMOS in Zukunft mehr in Wettbewerb zu Großproduzenten treten und entsprechenden Preisdruck spüren. Insbesondere in 2005 hat ELMOS die negative Folge des Wettbewerbs insofern gespürt, als einige Projekte nicht bis in die Produktion gebracht werden konnten, da die Kunden aufgrund von Parallelentwicklungen auf einen Wettbewerber zurückgreifen konnten.

ABHÄNGIGKEIT VON EINZELNEN MITARBEITERN

Die sehr entwicklungsintensive Geschäftstätigkeit des Unternehmens führt zu einem stark ausgeprägten und sehr spezifischen Ingenieur-Know-how – jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich für ELMOS eine erhöhte

Abhängigkeit von bestimmten Mitarbeitern. Das Fluktuationsrisiko reduziert sich bei ELMOS durch die erkennbar hohe Motivation und Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen.

ENTWICKLUNG NEUER PRODUKTE UND TECHNOLOGIEN

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten ist zu berücksichtigen, dass bei der Akquisition eines neuen Auftrages die Einmalkosten im Entwicklungsbereich heute in der Regel nicht mehr in vollem Umfang von den Kunden bezahlt werden. Diese vorab nicht gedeckten Entwicklungskosten werden über die späteren Stückzahlen in der Serie amortisiert. Hier besteht das Risiko, dass bei Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung münden, nicht amortisierte Kosten bei der Gesellschaft verbleiben. Gerade bei den hochvolumigen Aufträgen, um die sich eine größere Anzahl von Wettbewerbern bemüht, ist der Kunde in der Regel nicht bereit, die Entwicklungskosten zu übernehmen, sondern erwartet, dass diese vom Lieferanten vorfinanziert werden.

Bei Entwicklungen von Produkten, die ELMOS nicht rechtzeitig fertig stellt, kann die Lieferung möglicherweise erst ein Jahr später oder im schlimmsten Fall gar nicht erfolgen, wenn der Kunde eine Alternativlösung – entweder vom Konkurrenten oder als konventionelle Lösung – einsetzt.

Der Markt für die ELMOS-Produkte ist durch ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte gekennzeichnet. Der ELMOS-Erfolg ist deshalb stark von der Fähigkeit abhängig, neue komplexe Produkte preisgünstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzuführen und zu erreichen, dass diese Produkte von führenden Zulieferern der Automobilindustrie ausgewählt werden.

Der zukünftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fähigkeit abhängig, neue Entwicklungs- und Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -funktionen für ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie die Konkurrenten muss ELMOS ihre Technologie ständig weiterverbessern und neue Prozesstechnologien für die fortschreitende Verkleinerung der Strukturen im Submikronbereich entwickeln. Sollte ELMOS zukünftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und Produktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, dürfte dies signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Durch die Fähigkeit von ELMOS, ASICs für alle Arten von elektronischen Geräten im Automobil zu entwickeln und zu fertigen, sind ELMOS-Produkte in fast allen elektronischen Komponenten eines PKWs vertreten, so dass das Risiko des Wegfalls eines Auftrages für eine einzelne elektronische Komponente breit gestreut ist. Zwar könnte ein mehrjähriger Einbruch der Automobilindustrie, der die Automobilunternehmen veranlasst, keine neuen elektronischen Produkte zu entwickeln, die Gesellschaft in ihrer Entwicklung nachhaltig beeinträchtigen. Ein derartiger Einbruch ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abzusehen, insbesondere weil die Automobilindustrie in schlechteren Zeiten eher dazu neigt, die technische Ausstattung zu erhöhen.

BESCHAFFUNG

Die von ELMOS für die Fertigung benötigten Rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen Lieferanten verfügbar und unterliegen keinem Monopol. Branchentypisch ist dabei eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen fernöstlichen Partnern im Assembly-Bereich. Hier hat ELMOS mit dem Erwerb der ELMOS Advanced Packaging jedoch die Weichen für eine vertikale Vertiefung der Wertschöpfungskette gestellt.

PRODUKTHAFTUNG

Die von ELMOS produzierten ASICs werden als Komponenten in komplexe elektronische Systeme integriert. Fehler oder Funktionsmängel der von ELMOS hergestellten ASICs oder der elektronischen Systeme, in die sie integriert sind,

können direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit oder Leben Dritter beeinträchtigen. ELMOS ist nicht in der Lage, ihre Haftung gegenüber Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzverträgen zu reduzieren oder auszuschließen.

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von Fehlerquellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion in der Produktion im Regelfall mehrfach bei unterschiedlichen Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft die nach TS 16949, VDA 6.1 und QS 9000 zertifizierten Qualitätskontrollsysteme sowie weitreichende Testverfahren vor der Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, können sich Produktfehler möglicherweise erst nach Installation und Gebrauch der Produkte durch den Endverbraucher zeigen.

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifikationen nach sich ziehen und zu Störungen der Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen führen. Ein Qualitätsproblem ganzer Chargen könnte zudem zu Regressansprüchen der Kunden im Millionenbereich führen. Dieses Risiko ist angemessen versichert. All dies könnte jedoch negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

BETEILIGUNGSBEREICH

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die Tochtergesellschaften besteht die erhöhte Pflicht, mit entsprechenden Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mögliche finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen beziehungsweise zu minimieren. So sind für alle Tochtergesellschaften Geschäftspläne und Budgets erstellt worden, deren Überwachung sicherstellen wird, dass hieraus keine bestandsgefährdenden Risiken resultieren.

BETRIEBSUNTERBRECHUNG

Neben den bereits dargestellten und erläuterten Geschäftsrisiken ist nach Einschätzung von ELMOS das einzige betriebliche Risiko, das die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen und den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnte, das Risiko der Zerstörung der Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere Katastrophen. Zwar ist das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen versichert, jedoch bestünde in einem solchen Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schlüsselkunden. Dieses Risiko ist nicht versicherbar.

Dieses Risiko ist dadurch bereits reduziert, dass ab 2006 eine weitere Fertigungslinie (200mm-Linie) beim Fraunhofer-Institut in Duisburg von ELMOS betrieben wird. Zu einem späteren Zeitpunkt kann auch am Standort Dortmund in einem separaten Gebäude eine weitere Produktionslinie errichtet werden. Damit verfügt ELMOS über mehrere unabhängige Fertigungslinien, die autark produzieren können.

Die üblichen versicherbaren Risiken wie Feuer, Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht, insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten eines etwaigen Rückrufs, sind angemessen versichert. Weitere Risiken, die die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen oder den Fortbestand des Konzerns gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

NACHTRAGSBERICHT

Nach Ende des Geschäftsjahres wurde Dr. Anton Mindl mit Wirkung zum 1. Januar 2006 zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Darüber hinaus sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

PROGNOSEBERICHT

ELMOS wird sich zukünftig weiterhin als Nischenanbieter auf kundenspezifische Anwendungen für die Automobilindustrie fokussieren. Dabei sind die ELMOS-Technologie, das ELMOS-Design und die Produktion in der ELMOS-eigenen Fertigung feste Säulen dieser Strategie. Das erfolgreiche automobiler ASIC-Geschäft wird ergänzt durch die vermehrte Vermarktung von mikroelektronischen Modulen, die ASICs, Sensoren und funktionale Gehäuse, gegebenenfalls noch mit patentierten Technologien, in Form von Mikrosystemen vereinen. Weiter werden anwendungsspezifische Standardprodukte, die auf früher entwickelten ASICs basieren oder für die eine Nachfrage von mehreren Kunden absehbar ist, das Produktportfolio erweitern. Es ist zudem Ziel der ELMOS-Gruppe, den Umsatzanteil in sich schneller entwickelnden Märkten neben dem automobilen Markt zu erhöhen, um diese als Innovationstreiber nutzen zu können. Geographisch gesehen strebt ELMOS eine Durchdringung des nordamerikanischen Marktes und mittelfristig eine vermehrte Expansion in den asiatischen Markt an.

Für das Jahr 2006 wird allgemein mit einer moderaten Steigerung im weltweiten Halbleitermarkt gerechnet; in der Automobilindustrie zeigen die Prognosen auf keine größeren Veränderungen in der weltweiten Nachfrage. Aufgrund des kontinuierlich steigenden Elektronikanteils je Fahrzeug wird der Markt für automobiler Halbleiter aber weiter kräftig steigen. Für die automobilen Halbleiterchips wird ein etwa acht- bis zehnprozentiges Wachstum bis 2010 prognostiziert.

Das Jahr 2006 ist in Bezug auf den Auftragseingang freundlich gestartet. Das Book-to-Bill Verhältnis von 1,1 zu Anfang 2006 bestärkt unsere Erwartung, ein Umsatzwachstum von 10 Prozent wie geplant zu erreichen. Für das erste Halbjahr erwarten wir noch keine weitere Belegung des Geschäftes. Neben dem Auftragseingang ist es für den Verlauf des Jahres wesentlich, die in der zweiten Jahreshälfte anstehenden Serienanläufe erfolgreich und termingerecht zu gestalten.

Das laufende Jahr 2006 ist weiterhin in hohem Maße durch den Produktionsanlauf beim IMS in Duisburg geprägt. Die Geschwindigkeit, mit der die Kunden die Produkte für die Duisburg-Produktionslinie qualifizieren und freigeben, ist entscheidend für die kosteneffektive Nutzung der 200mm-Fertigung. Die Umstellung laufender großvolumiger Produkte auf 200mm Waferdurchmesser bietet dann die Chance, die Herstellkosten im Vergleich zu 150mm Wafern zu senken und die Produktionsmengen zu erhöhen.

Wegen der Bedeutung dieses Anlaufszenarios für die Margensituation arbeiten wir an dieser Aufgabenstellung sowohl von der technischen Umsetzung her als auch auf Kundenseite mit hoher Priorität.

Dortmund, im März 2006
Der Vorstand

Dr. Anton Mindl

Dr. Klaus Weyer

Reinhard Senf

Dr. Frank Rottmann